

技术参数

GL5901

日期：08/2023

应用介绍

特点

一款单组分热固化环氧胶，可低温固化，具有高强度，低CTE，易返修等特点；并具有良好的耐湿热高可靠性性能；适用于电子器件的结构性粘接。

粘接材料

金属，塑料/PCB、LCP，玻璃等

典型应用

电子元器件结构性粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色	
粘度(cps)	8160	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	10min@80°C	
有效期@ -20°C,月	6	

*固化温度是指固化时胶水本身达到的温度。

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	76D	ASTM D-2240
玻璃化温度	30°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
CTE (ppm/°C)	α_1 :55	
	α_2 :120	
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	
工作温度范围	-55°C—150°C	

储存和使用方法

产品需低于-20°C环境中保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

1. 本技术数据表(TDS)中提供的信息和应用建议是基于截至 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品可以有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知用户关于内容的更改。

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

